

## 2014年度秋季大会 オーガナイズドセッション平均聴講者数ベスト3（11名）

	分類 コード	セッション名	オーガナイザー	各講演 平均聴講者数
受賞	B02	高能率・高精度化のための切削工具	臼杵 年(島根大学) 新谷 一博(金沢工業大学) 關谷 克彦(広島大学) 笹原 弘之(東京農工大学)	56.78
受賞	B17	プラナリゼーションCMPとその応用	近藤 誠一(日立化成工業株式会社) 黒河 周平(九州大学) 畝田 道雄(金沢工業大学)	53.88
受賞	B01	工作機械の高速高精度化	白瀬 敬一(神戸大学) 松原 厚(京都大学) 森本 喜隆(金沢工業大学) 家城 淳(オークマ株式会社)	43.40

2014年度秋季大会ベストオーガナイザー賞は、平均聴講者数ベスト3セッションオーガナイザーの上記11名の方に決定いたしました。

# 2014年度秋季大会

## ◆ベストプレゼンテーション賞(21名)

2013年度春季大会から実施の新選考基準により、以下21名の方の受賞が決定いたしました。新選考基準の詳細については、上記の「春秋大会ベストプレゼンテーション(BP)賞選考基準について」をご確認下さい。

講演番号	講演者氏名	講演者所属	講演題目	セッション名
A46	御手洗 真人	徳山工業高等専門学校	CMPIにおけるウェーハ・研磨パッド間スラリー流れの可視化	プラナリゼーションCMPとその応用
A69	高木 昭宏	中部大学大学院	低熱膨張セラミックス製軸対称放物面鏡の精密加工	曲面・微細形状・機能性材料の超精密加工と計測
B04	榊原 隆	東京大学	微細流路の複合化による多自由度マイクロハイドロリックアクチュエータの開発	ロボティクス
B21	松山 祐樹	大阪大学	製品個体の集合を対象とした製品ライフサイクルのモデリング手法の提案	持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング
B46	伴野 元紀	豊橋技術科学大学大学院	細胞機能解析のためのナノニードル搭載型バイオプローブの開発(第10報) - 段付き中空ニードル探針の作製プロセスの検討 -	バイオ・医療への応用展開
B65	洞山 正幸	東海大学大学院	マイクロ流体制御による一細胞スケールでの液性刺激	バイオ・医療への応用展開
E16	MI DAHAI	東京農工大学	ECM Method for Holes with Complex Internal Features by Using Surface-resistance-adjusted Tool Electrodes	電気エネルギー応用加工
E35	杉浦 崇仁	大阪大学大学院	触媒表面基準エッチング法による金属酸化物材料の高効率平坦化加工	ナノ精度表面創成法とその応用
F08	田原 樹	関西大学	単色撮像素子と単一参照ビームを用いるシングルショットカラーデジタルホログラフィ	メカノフotonクス
G05	藤圭 亮	九州工業大学	ガラス・シリコン接合型マイクロ流路デバイスの作製	マイクロ/ナノシステム
G34	石井 貴之	東海大学	JEM-EUSO計画のためのフロントレンズの製作	ナノ表面研削/ELID研削
H38	吉田 祐未	東京工業大学大学院	電子線リソグラフィを用いたマイクロセグメント構造DLC膜の作製	表面処理・機能薄膜
I21	中村 竜太	秋田県産業技術センター	電界砥粒制御技術を応用した電界非接触微粒子攪拌装置の開発	次世代基盤研磨技術の創成
J63	長谷 亜蘭	埼玉工業大学	マイクロ旋盤加工におけるAEセンシングを用いた加工状態認識 - 端面切削時のAE信号の特徴 -	マイクロ生産機械システム
K18	青木 友弥	株式会社豊田中央研究所	切りくず接触長さの拘束による旋削切りくずの誘導に関する基礎的検討	高能率・高精度化のための切削工具
K44	森口 昌樹	中央大学	三角形メッシュのReebグラフを計算する最適な出力依存アルゴリズム	形状モデリングの基礎と応用
L02	橋本 匡史	橋本鉄工株式会社	加工変質層における応力緩和挙動の高温その場測定	砥粒加工の新展開
N18	金羽木 惇二	埼玉大学大学院	フェムト秒レーザ加工による樹脂の3次元加工(第2報) - 加工特性の調査および空間創成 -	レーザ加工
O38	四田 一高	金沢工業大学大学院	遊離砥粒マルチワイヤソーの加工部における砥粒挙動に関する研究	切断加工
P40	清田 大樹	名古屋工業大学	工具・切りくず間の付着状態を考慮した切削モデルの検討と工具表面マイクロテクスチャの加工力低減効果	マイクロ・ナノ加工とその応用
R21	山崎 行浩	千葉大学大学院	背分力フリー切削法に関する研究	マイクロ・ナノ加工とその応用